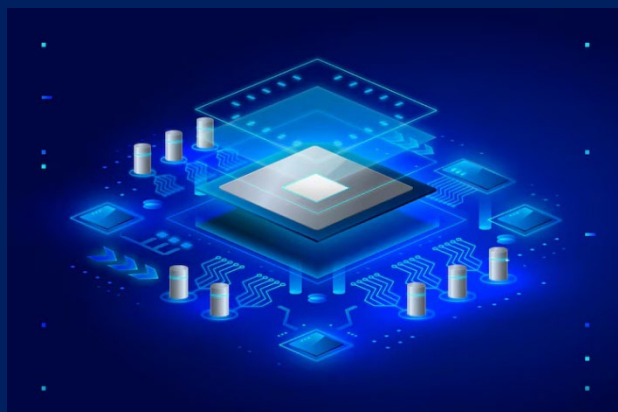


エレクトロニクス実装学会関西支部

第 32 回若手研究会セミナー

～パワーエレクトロニクス実装の基礎及び求める性能と応用～



2025 年 12 月 2 日(火)13:00～16:30

開催方式:現地参加&オンライン視聴

会場:大阪大学中之島センター 7 階

(大阪府大阪市北区中之島 4-3-53)

<https://www.onc.osaka-u.ac.jp/access/>

オンライン:zoom ウェビナー

セミナー開催趣旨

近年、再生可能エネルギーや電気自動車、次世代通信インフラの急速な普及に伴い、電力変換効率の向上とシステム小型化を実現するパワーエレクトロニクス技術の重要性が一層高まっています。本セミナーでは、パワーエレクトロニクス実装の基礎を整理し、信頼性・熱マネジメント・デバイス実装に求められる性能について解説します。また、将来のブレークスルー材料として注目される、ダイヤモンド基板を用いた先端パワーデバイス技術の可能性と応用展望についても紹介し、基盤技術と革新的材料技術の両面から議論を深めます。

セミナー参加費用と申し込み

定員:現地参加 70 名、オンライン視聴 100 名 (先着申込順)

会員/賛助会員/協賛会員:5,000 円

若手会員/シニア会員:2,000 円

一般:10,000 円 一般学生:1,000 円※

学生会員/名誉会員:無料

※一般学生は学会入会すると参加無料、会員の推薦があれば入会金免除・在学中の年会費は無料

<https://service.kktcs.co.jp/smms2/event/jiep/624>

参加申し込み

申し込み締切:11 月 25 日迄

問い合わせ先:エレクトロニクス実装学会事務局 info@jiep.or.jp

申し込み QR コード



開催プログラム

13:00～13:05 開会挨拶 大阪大学 F3D 実装協働研究所 陳 伝彤

13:05～14:45 基調講演

三菱電機株式会社 先端技術総合研究所

西村 隆 氏(JIEP 理事)

「パワエレ機器と次世代モビリティ産業」

パワーエレクトロニクス機器の社会的役割とニーズを概説し、パワーモジュールの高出力化とそれを可能とする高放熱技術の現状を報告する。さらに、次世代モビリティ産業の開発トレンドを紹介する。



<休憩 14:45～14:55>

14:55～16:25 招待講演

立命館大学 理工学部電気電子工学科 准教授

藤井 茉美 氏

「ワイドバンドギャップ材料を用いた電子デバイスの信頼性解析」

ワイドバンドギャップ半導体の実用化において必須となる信頼性解析について、IGZO 薄膜トランジスタやダイヤモンド素子の電氣的な劣化を対象とした解析・欠陥評価事例を紹介する。



16:25 ～16:30 閉会挨拶 大阪産業技術研究所 柏木 行康